

联络人

投资人关系 +886 3397 5999 ext. 1204 ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2017 年第四季自结财务报告

2018年2月6日

稳懋半导体,全球最大砷化镓晶圆代工服务公司,已于今(6)日公告 2017 年第四季自结财务报告。

2017年第四季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 55.81 亿元,较前一年同期增加 74%,较前季增加 27%
- ◆ 本季合并毛利率为 38.3%, 较前季增加 0.5 个百分点; 本季营业净利率 28.9%, 较前季增加 1 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 16.15 亿元, 较前一年同期增加 176%, 较前季增加 31%
- ◆ 本季税后净利为新台币 13.27 亿元,较前一年同期增加 141%,较前季增加 14%; 每股盈余为新台币 3.31 元,前季为新台币 2.93 元
- ◆ 全年合并营收为新台币 170.86 亿元,每股盈余为新台币 9.34 元

2018年第一季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的 影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 以美金计算,营收预期将较去年第四季下滑 high-teens 百分比,但后续若汇率并未 好转,台币营收预期将下滑 low twenties 百分比。
- ◆ 毛利率则预期将低于去年第四季。

管理者评论

"回顾2017年第四季,稳懋营收及获利分别达到55.8亿元及每股3.31元的单季历史高点,我们也很高兴看到2017年全年营收及税后净利继2016年之后再次创下历史新高,分别较前一年成长25%及20%,EPS更创下9.34元的新高纪录。综观2017年,对于稳懋来说是充满挑战但却也是丰收的一年,成果如下:

第一、2017 年除了既有的微波通讯业务成长强劲之外,光电组件应用在消费性产品上也于下 半年开始出货,是稳懋多年来致力于三五族半导体技术开发,并将技术扩散到其他应用领域 有具体成果的一年。 第二、2017 年是 MSCI 肯定稳懋经营绩效,将稳懋首次纳入全球标准指数成分股的一年。

第三、稳慰自 1999 年成立以来即一直期望全球 IDM(整合组件厂)大厂客户能够依赖稳慰的制程技术及产能,最终做出产品全数委由稳慰代工生产的决定,2017 年也是我们透过私募与IDM 客户达成此策略联盟目标的一年。

第四、2017 年是稳懋连续第三次获得公司治理评鉴排名前5%企业殊荣的一年。

展望未来,我们持续看好光电组件应用的发展,尤其是 3D 感测功能应用在手持式装置上稳 想具有领先地位,预期往后几年随着更多手持式装置及更多品牌的导入,加上未来 AR/VR 的 应用、汽车先进驾驶辅助系统的成熟,光电组件的应用面可望高速成长。另外,我们对于几 年之内即将到来的 5G 通讯应用也抱以高度期待,不单是因为 5G 时代手持式装置频率将延伸 到 Sub-6 GHz,PA 需求将大幅增加,来自于 5G 基础建设 (Infrastructure) 的需求也将同步成长, 尤其是基地台将应用到稳懋最擅长及独特的高频率、高功率组件技术,如整合型毫米波组件 及氮化镓技术等,将明显拉大稳懋与竞争者之间的距离。所以,我们相信光电组件及 5G 将 成为稳懋未来几年的两大成长引擎。

最后,展望2018 年第一季,以美金计算,营收预期将较去年第四季下滑 high-teens 百分比,但后续若汇率并未好转,台币营收预期将下滑 low twenties 百分比,不过与去年同期比较,预期还是有大幅度的成长。至于毛利率则预期将低于去年第四季。"

关于稳懋半导体

稳懋半导体成立于 1999 年,位于林口华亚科技园区,是全球首座以六英吋晶圆生产砷化镓微波集成电路(GaAs MMIC)的专业晶圆代工服务公司。稳懋拥有完整的技术团队及最先进的砷化镓微波晶体管及集成电路制造技术及生产设备,客户群除了全球射频集成电路设计公司(RFIC Design Houses)外,并致力吸引与全球整合组件制造(IDM)大厂合作。在制程技术发展方面,稳懋以多元化及领先为原则,期能提供客户最完整的服务。在无线宽带通讯的微波高科技领域中,稳懋目前提供两大类砷化镓晶体管制程技术: 异质接面双极性晶体管(HBT)和应变式异质接面高迁移率晶体管(pHEMT),二者均为最尖端的制程技术。在光通讯及 3D 感测领域中,稳懋更以 MMIC 生产技术为基础,提供光电产品的开发与生产制造。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期,但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外,公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。